

证券代码：601231
转债代码：113045

证券简称：环旭电子
转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司 2023 年年度业绩说明会活动记录

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2024 年 4 月 19 日
地点	同顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/ir
上市公司 参会人员	陈昌益（董事长）、黄江东（独立董事）、郭薇（独立董事）、史金鹏（董事会秘书）、刘丹阳（财务总监）
业绩说明会 Q&A 记录	<p>【问题】 请问陈董，公司有在年度报告中提到关于 EMS 行业重构以及“经贸区域化”方面的变化趋势，环旭电子作为 EMS 行业的代表厂商，请介绍一下您对 EMS 行业未来几年变化趋势和环旭的策略？有看到公司在墨西哥继续增购土地，公司未来主要看好哪些在墨西哥的业务机会？</p> <p>【回答】 有关「经贸区域化」这个趋势，它代表的是一个从过去基于「比较利益」、「专业分工」、及「营运效率」来发展的产业及供应链，转变为以「区域经济安全」、「分散生产风险」及「在地制造价值」来出发的运作模式，它带动的「制造回流」也加速了整体供应链的区域化，从「长链」走向「短链」。面对这个发展趋势，环旭在过去 5 年，就已经逐步推进全球在地化的发展策略，全球产能布局也已经趋于完备。刚才在报告中也有提到，我们目前在全球共有 30 个生产据点，未来将扩展至 35 个，而针对目前的生产据点，我们将会透过工业 4.0 的数字化、自动化及智能化来提高生产制造的效率、质量及竞争力，以克服「在地制造」在劳动成本上的劣势，我们正有系统地在提升智能制造和自动化生产，并规划在 2028 年将会有五座关灯工厂，以逐步实现全面的自动化生产。</p>

同时，我们也正在加速建立以客户需求为导向的供应链的生态圈，即透过更紧密地与外部上游厂商的合作，来提供客户异质化的服务，与客户形成牢固的合作伙伴关系。另外，再透过提升自主研发的能力，尤其是在制造相关的工程研发与设计，来增加服务客户的价值，以进一步增强与客户间的粘性。

最后，有关环旭在墨西哥的投资布局，我们观察到在「美加墨贸易协议」要求汽车产业提高零部件在北美本地采购的比例之后，又更进一步带动相关产业到墨西哥投资设厂，当地相关产业链也快速形成，产业集群的效应正在逐步显现，也因此，墨西哥是我们在海外重点布局的区域之一。今年下半年将完工的 Guadalajara 二厂，将用于服务汽车电子与工业客户，并将与 Guadalajara 一厂和 Tijuana 厂一起来开拓北美市场，我们也将针对近期在当地新购入的土地来进行长期规划，以更进一步拓展在北美市场的份额。

【问题】环旭近年来战略方向强调了海外生产据点的布局，也在行动上卓见成效，在国内的产能方面亦有所提升。请问郭董事，您作为公司独董，也是公司战略委员会委员，请问您如何看待公司在国内的业务发展机会？

【回答】首先，尽管近年来环旭对海外产能投资力度比较大，但环旭也有计划通过扩展和增强国内的业务来充分利用国内的产能，比如，拓展国内模组化产品的业务，与消费电子、汽车电子的厂商合作开发模组或模块产品，还有积极拓展外资企业服务国内市场产品的综合制造服务业务。环旭在最具竞争优势的模组化产品领域，希望与国内上下游产业链强化合作，推动包括 SiP 在内的模组化技术的应用，帮助实现客户的产品升级。

第二点，环旭通过全球化的生产据点布局，能够为跨国运营企业提供不同区域的在地化制造服务，通过环旭的运营体系，能够服务跨国公司在中国的制造服务需求，也能帮助国内企业在海外完成生产与交付，这是环旭相比国内同行的一项差异化竞争优势。

例如，环旭的昆山工厂为一家日本企业国内销售的产品提供制造服务，营收增长较快。

第三点，中国大陆的供应链具备成本优势，在众多的产品研发领域，国内人才同样具备非常强的竞争力。环旭凭借国内的产业基础，有机会将国内供应链与全球制造服务体系更紧密的结合起来，通过加强国内的研发体系建设，支持与服务海外生产据点的 JDM 业务模式，相比海外竞争对手未来实现更强的成本竞争力。

最后一点，我看到环旭也在加强策略投资，包括企业并购和企业创投。围绕环旭的核心业务，

环旭也在关注国内的策略投资机会，在企业创投方面已经投资了几家国内的企业和产业基金。当前，国内资本市场的并购整合机会明显增加，在这方面环旭应该也会有积极的成果。

【问题】黄董事，请您评价一下环旭在公司治理方面的情况？在强监管、重合规的时代背景下，好的公司治理对公司发展有何帮助？

【回答】公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。具体来说：

（一）在股东与股东会方面：公司能够根据法规要求，召集、召开股东会，股东会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。

（二）在控股股东与上市公司的关系方面：公司与控股股东相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

（三）在董事和董事会方面：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，独立董事在审议关联交易、内部控制规范的过程中提出了宝贵的意见与建议。

（四）在监事和监事会方面：公司监事会能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表意见。

（五）关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标

	<p>准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。</p> <p>（六）在信息披露与透明度方面：公司严格按照有关法规要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。</p> <p>（七）在投资者关系及相关利益者方面：公司牢固树立回报股东的意识，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。公司积极接待各类投资者，并在公司网站上开设投资者关系板块，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。公司能够充分尊重和维护员工、供应商、客户、银行等利益相关者合法权益，在经济交往中做到互惠互利，以推动公司持续、健康发展。</p> <p>（八）在内部控制制度的建立健全方面：公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与评价。</p> <p>总体上，公司治理规范、股东会、董事会、监事会、管理层各司其职、有效运作，内部控制完善有效，对公司的高质量发展起到了良好推动作用。</p> <p>在强监管、重合规的时代背景下，好的公司治理对公司发展有何帮助？</p> <p>资本市场新形势对上市公司证券合规提出新要求。一是新法新规陆续出台，监管态势趋紧。近年来，包括新《证券法》在内的涉及资本市场一系列新的证券法律法规、规章制度颁布出台，对上市公司证券合规提出了新的要求和挑战。二是立体化追责力度升级。“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为的执法形势下，上市公司及其董监高面临的行政、民事、刑事等法律风险急剧加大。证券监管部门强调对违法违规行为实行“行政处罚+民事赔偿+刑事追责”全方位追责。在此形势下，上市公司完善治理、强化合规非常重要。</p> <p>一是好的公司治理是上市公司规范运作、合规经营的基础。公司治理是公司内部处理分权与制衡、激励与约束问题的一系列制度安排，公司治理规范，公司就能有较好的发展基础和保障；反之，公司治理不健全，则是发展上的隐忧，在某些时候可能酿成大祸。从实践中来看，治理完善的公司不会发生大的违规风险，而反过来，那些发生严重违规事件的公司则都能在其公司治理上找到根源。</p>
--	---

二是好的公司治理是公司高质量发展的重要动力。上市公司高质量发展是当前重要的时代主题。只有公司治理完善，股东会、董事会、监事会、管理层能够各司其职，处于良好的分权制衡运作状态，公司的长治久安、基业长青才有保障和动力；否则，有可能一时发展不错，但长期看风险极大，容易栽跟头、走弯路，甚至造成不可逆的致命错误。只有在良好公司治理基础上的发展才有可能实现高质量发展。

【问题】公司 2021 年发行可转债距今已有三年，请问公司承担的财务成本情况如何？公司股价过去也曾满足过下修转股价格的条件，请问公司董事会决策不下修转股价格的主要原因是什么？

【回答】本公司于 2021 年 3 月 4 日发行票面金额为人民币 100 元的可转换债券(以下简称“可转债”)3,450 万张。可转债票面年利率为第一年 0.1%、第二年 0.2%、第三年 0.6%、第四年 1.3%、第五年 1.8%、第六年 2.0% 并依当时市场利率 4.3% 摊销增加的利息费用(不增加实际支付利息),可转换公司债券过去三年合并计入公司财务费用总额约为人民币 3.81 亿,其中按面值计提支付的利息费用为人民币 0.27 亿。

有关公司一月三日董事会决策不下修转股价格的主要原因:

环旭转债转股价格为 19.06 元/股,根据企业会计准则第 37 号第四章第六节第三条的规定,下修转股价格后股票转换所能获得对价的公允价值与下修前股票转换所能获得的对价的公允价值之间的差额,公司应提列为损失。

由公司财务部门与会计师的模拟测算,因下修转股价公司可能需要在当期一次性提列较大的损失,从而影响当期净利润。

举例而言,根据 2024 年 4 月 9 日股价人民币 14.02 元,若下修转股价格为人民币 17 元,将会认列之损失将超过为人民币 3 亿,如下修至目前股价水平认列之损失将超过为人民币 8 亿。为不对当期净利润造成重大影响影响。经公司董事会讨论,审慎考虑不对公司可转债转股价进行下修。

【问题】近年来,公司在墨西哥的投资持续增加,根据年报中公布的数据,2023 年墨西哥工厂为亏损状态,请问公司在墨西哥工厂的综合成本水平如何?未来如何优化?

【回答】墨西哥公司于 2022 年已实现获利,然而在 2023 年迎来新一轮业务扩充,在投资

增加初期加上当地营运用及财务成本增加呈现小幅亏损。

未来公司将从以下几个方面来优化包括墨西哥工厂在内的海外工厂的综合成本与竞争力：

- （1）提高供应链集中统一采购的定价能力，以环旭大批量集中采购的报价模式，为海外各个工厂争取更优的材料成本；
- （2）持续提升墨西哥工厂等海外工厂的生产效率、智能制造能力；
- （3）扩展公司在产业链纵向的服务能力，如增强研发、设计方面的能力，以向客户获得更好地产品报价；
- （4）持续做好各海外工厂的费用水平管控。

【问题】当前与 AI 相关的领域发展面临重大的发展机遇和成长潜力，会带动哪些产品的需求大幅增长，公司哪些业务板块将受益？

【回答】AI 时代已经到来，相信 AI 技术会像互联网技术一样，赋能各行各业发生深刻变革。AI 需要强大的算力完成大模型训练及推理，首先是 GPU 芯片和 AI 服务器供不应求，也带动边缘服务器的需求成长。除了算力，AI 大模型需要更高效率、更低延迟的数据传输和交换，推动网络基础设施的升级，高速光纤网络、高速光模块、高带宽内存(HBM)、高速网卡及高速交换机、固态硬盘(SSD)、散热及服务器冷却系统等硬件产品的需求也随之快速成长。公司云端及存储类产品，核心产品包括服务器主板、高速交换机、固态硬盘等，将会直接受益。

通过 AI 的赋能，对我们生活的影响将是持续且深远的。当下我们已经看到 AI PC 和 AI Phone 的陆续推出，个人电脑和手机的功能正在被重新定义，未来越来越多的消费电子产品也将被重新定义。可以预见，未来消费电子产品在交互方式、智能物联、智能感知、数据处理及传输、智能服务等很多方面都将实现重大突破，在居家、工作、出行、社交等各种生活场景中，大家都离不开 AI 赋能的手机、电脑、智能穿戴等核心终端设备。消费电子的全面智能化升级，必须依赖高带宽、低延时、易接入的新一代无线通讯技术，如 WiFi 7、UWB、毫米波等，在极致追求“轻薄短小”的消费电子产品上，SiP 模组凭借高集成度、高可靠性、低功耗等优点，相信也能够得到日益广泛的应用和推广。环旭电子是 SiP 模组制造的全球领先厂商，无线通讯和智能穿戴相关的 SiP 模组一直是公司的优势产品，公司看好消费电子智能化升级带来的模组化产品需求大幅增长的机会。

2023 年是生成式 AI 的元年，AI 未来的发展空间无法限量，不仅仅是算力和智能化的提升，

通过与物联网、大数据等技术深度融合，将广泛服务各行各业，也将深刻影响公司其他业务板块的产品升级和技术迭代。

【问题】你们的交换机好不好

【回答】公司为客户提供高速交换机产品的主板及整机制造服务，2023 年营收大幅成长，但占公司合并营收的比例较低，当前行业景气度较好，预计今年能继续成长。

【问题】怎么可以让投资者有正收益

【回答】在稳健经营的同时，公司也以“为股东创造价值、与股东共享成长”为使命。为充分维护股东利益，增强投资者信心，公司持续推出股份回购计划，在 2019 年、2021 年、2022 年分别回购 13,037,477、16,042,278、9,356,317 股。2024 年初，公司推出新一期回购计划，回购资金总额不低于人民币 1 亿元。

【问题】领导对公司未来发展有什么规划

【回答】公司将坚持“模组化、多元化、全球化”的发展战略，提升垂直整合及智能制造能力，完善全球化生产运营体系，促进内生成长，同时持续着力投资并购活动，积极寻求外部成长机会。面对宏观经济增速放缓的挑战，公司将更审慎安排人力资源和资本支出安排，做好达成年度财务目标和长期成长计划的平衡，依据业务发展和全球营运的需要，扩大数字化管理系统的范围，不断提升工厂智能化、自动化生产水平。主要从以下几个方面着手：
(1) 努力保持在核心客户 SiP 模组业务中的市场份额，加强微小化技术和 SiP 模组的应用推广、新产品研发及新客户拓展，继续做大模组业务营收规模；
(2) 持续投资北美、东欧、亚太的产能，成立区域性 EMS 业务部门直接服务在地客户，发挥在地制造服务和差异化竞争优势，拓展汽车电子、工业类业务；
(3) 提升车用功率模组及动力总成产品的成本竞争力；
(4) 提升软件设计和解决方案能力，服务客户需求；
(5) 持续加强数字化转型，推进智能制造在各厂区的进程，利用 IT 技术平台进行升级，打造面向未来的产业竞争力。

【问题】1 季度业绩如何

【回答】公司将于 4 月 24 日收盘后披露一季报，请您关注公司公告，谢谢。

【问题】 请问贵司近期的回购进展如何？

【回答】 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购股份 366,300 股，占公司总股本的比例约为 0.02%，后续的回购情况请您关注公司的公告，谢谢。

【问题】 目前算力显卡厂商开始把 GPU 与 HBM 内存封装在一起，这种封装技术属于环旭电子的 SiP 封装还是通过环旭电子控股股东日月光半导体晶圆厂封装的 Chiplet 封装来实现的？

【回答】 目前芯片厂商主要使用 CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) 先进封装技术将 GPU、HBM 堆叠在一起并封装在基板上，缩小芯片空间，并减少功耗和制造成本。公司的 SiP 模组是异构集成的电子系统，是将芯片及被动器件整合在一个模块中，达到缩小功能模块面积、提高电路系统效率及屏蔽电磁干扰等效果，当前 SiP 更多的应用在对“轻薄短小”需求度较高的消费类电子产品中。两种技术目前应用的场景有所差异。

【问题】 对于现在低迷的股价，管理层难道没有想法做好上市公司的市值管理吗？回购也迟迟不动，是对公司的发展没有信心吗？

【回答】 公司一直以“为股东创造价值、与股东共享成长”为使命。为充分维护股东利益，增强投资者信心，公司持续推出股份回购计划，在 2019 年、2021 年、2022 年分别回购 13,037,477、16,042,278、9,356,317 股。2024 年初，公司推出新一期回购计划，回购资金总额不低于人民币 1 亿元；截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购股份 366,300 股，占公司总股本的比例约为 0.02%，后续的回购情况请您关注公司的公告。

【问题】 环旭对于 MR 头戴设备的更新迭代是一个什么样的态度看法，有机会成为继 Watch 之后又一个现象级产品吗？

【回答】 近几年元宇宙领域备受关注，游戏、科技、互联网行业的公司竞相追逐 VR 产业，AR、MR 头显产品也推陈出新。头部消费电子品牌商也提出了全新的“空间计算”概念，并应用在其全新的头戴显示设备中。以“眼动”加“手势”的控制方式与设备交互，结合空间计算的能力，能为消费者带来全新的体验。未来，随着头戴显示产品的迭代进步，无论是 MR、AR、VR 各种形态的产品，亦或是这种空间计算设备，一定会在使用体验上更加优秀，包括在

重量、体积、交互、视听、应用、续航、性能等各个方面，会是各大品牌厂商的创新/进步着力点。未来，包括头戴显示设备，以及其他的智能穿戴、智能手机产品，轻薄短小一定是未来的趋势，这也正好契合环旭做的 SiP 模组的优势/特点，期望未来公司的 SiP 模组能在这些产品中有更好/更新的应用机会。

【问题】 SiP 是什么 技术先进吗

【回答】 SiP 模组最能满足消费电子产品日益严苛的“轻薄短小”、高集成度、低功耗、高可靠性的要求。SiP 是一种异构集成技术，其系统级整合的能力可以集成具有不同技术的组件，例如将模拟和数字电路整合，或将高性能和低功耗组件包含主动和被动组件整合，形成完整的电子系统。SiP 可以集成来自不同制造商的多样组件，实现定制化并选择每个功能的最佳性能组件。这种灵活性和外形可塑性在需要特定功能或专用组件时尤为重要。通过使用封装工艺，实现了对 SiP 中个别组件的系统级测试和优化，最大程度地减少故障风险，提升整体系统产量，进一步增强电子系统的可靠性和稳定性。通过对内凹槽、隔间屏蔽，对外覆形屏蔽，能够有效阻断 SiP 中各个不同 IC 之间的电磁干扰，也能阻断 SiP 外部的其他的电磁干扰。SiP 提供了系统集成的可扩展性选项。制造商可以根据系统要求和未来升级的需要添加或移除组件。这种可扩展性使得产品能够更容易地适应不断变化的市场需求和技术迭代进步。

【问题】 有没有做智能物联网的东西

【回答】 公司有为客户的智能音箱、电视盒子等智能物联网设备提供 SiP 模组产品，也有为客户制造路由器产品。

【问题】 环旭做手机的什么产品？

【回答】 公司目前出货应用至手机的产品主要包括：WiFi 模组、UWB 模组、5G 毫米波模组、指纹辨识模组、SiPlet，服务全球最知名的消费电子品牌厂商。

【问题】 公司和英伟达及其子公司 Mellanox 合作的相关情况。

【回答】 由于商业保密合约的原因，公司不能对具体客户的业务情况进行评论。公司为客户

	<p>提供高速交换机产品的主板及整机制造服务，2023 年营收大幅增长，但占公司合并营收的比例较低，今年将继续保持增长。谢谢！</p> <p>【问题】你们 siP 有没有什么技术优势 以后怎么保持优势</p> <p>【回答】公司坚持深耕 SiP 模组的研发领域，保持业界领先。2020 年底，公司设立微小化研发创新中心（MCC），围绕微小化技术和 SiP 模组的应用推广，服务国内外客户对微小化、模组化的产品需要，提供从设计到制造的“一站式服务”。“微小化”产品的设计制造能力是公司的竞争优势，公司在 SiP 模组设计与制程工艺方面不断精进，在 SiP 制程各方面不断突破技术挑战，满足高稳定性、高集成度的产品要求。在单面塑封方面，可以做到全面塑封或选择性塑封，可根据客户需求开发芯片埋入、金线/晶圆键合封装等制程；在双面塑封方面，已引入插入式互联，后续会开发 3D 结构以及软硬板结合，进一步缩小产品尺寸；公司将引入晶圆制造前段制程，包括晶圆减薄、晶圆划片，结合当前 SiP 制程，实现 Wafer-In-Module-Out。</p> <p>【问题】公司一直在强调汽车的智能化，你们有哪些产品</p> <p>【回答】公司在汽车电子“智能化”相关产品，主要包括智能座舱、自动辅助驾驶、车载通讯等方面，如车载信息娱乐系统控制板、HUD 控制板、NAD 模组、汽车天线模组、汽车 CPU 模组、车载以太网闸道器、自动驾驶控制器（ASM、TMM、VPM）等。</p> <p>【问题】服务器的芯片很多用了 Chiplet 的工艺，有没有可能用 sip</p> <p>【回答】SiP 模组技术可以通过异构集成实现 PCBA 的微小化，与 SoC 和 Chiplet 能够发挥的作用还是有差别。公司今年有在官网发布了介绍 SiP、SoC、Chiplet 这三种主流微小化技术的介绍视频，可以帮助投资者更多了解微小化技术的特点，欢迎投资者到公司官网的影音中心 (www.usiglobal.com/cn/videos) 查询和观看，谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 19 日